

# 中国芯片设计市场运行状况分析与投资发展研究报告2022-2028年

产品名称	中国芯片设计市场运行状况分析与投资发展研究报告2022-2028年
公司名称	北京中研华泰信息技术研究院
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区北苑东路19号中国铁建大厦
联系电话	010-56231698 18766830652

## 产品详情

中国芯片设计市场运行状况分析与投资发展研究报告2022-2028年.....【报告编号

】 355703【出版日期】 2022年10月【出版机构】 中研华泰研究院【交付方式】

EMIL电子版或特快专递【报告价格】 纸质版:6500元 电子版:6800元

纸质版+电子版:7000元【联系人员】

刘亚 免费售后服务一年，具体内容及订购流程欢迎咨询客服人员 章 芯片设计行业相关概述1.1

芯片的概念和分类1.1.1 芯片基本概念1.1.2 相关概念区分1.1.3 芯片主要分类1.2 芯片产业链结构1.2.1

芯片产业链结构1.2.2 芯片生产流程图1.2.3 产业链核心环节1.3 芯片设计行业概述1.3.1

芯片设计行业简介1.3.2 芯片设计基本分类1.3.3 芯片设计产业图谱 第二章

2020-2022年中国芯片设计行业发展环境2.1 经济环境2.1.1 国内宏观经济概况2.1.2 工业经济运行情况2.1.3

固定资产投资状况2.1.4 国内宏观经济展望2.2 政策环境2.2.1 智能制造发展战略2.2.2 中国制造支持政策2.2.3

集成电路相关政策2.2.4 地方芯片产业政策2.2.5 产业投资基金支持2.3 社会环境2.3.1 移动网络运行状况2.3.2

电子信息产业增速2.3.3 电子信息设备规模2.3.4 研发经费投入增长2.4 技术环境2.4.1 芯片技术专利申请2.4.2

芯片技术创新升级2.4.3 芯片技术发展方向 第三章 2020-2022年中国芯片产业发展分析3.1

中国芯片产业发展综述3.1.1 产业基本特征3.1.2 产业发展背景3.1.3 产业发展意义3.1.4 产业发展现状3.2

2020-2022年中国芯片市场运行状况3.2.1 产业销售规模3.2.2 市场结构分析3.2.3 产品产量规模3.2.4

企业发展状况3.2.5 区域发展格局3.3 2020-2022年中国芯片细分市场发展情况3.3.1 5G芯片3.3.2 AI芯片3.3.3

生物芯片3.3.4 车载芯片3.3.5 电源管理芯片3.4 2020-2022年中国集成电路进出口数据分析3.4.1

进出口总量数据分析3.4.2 主要贸易国进出口情况分析3.4.3 主要省市进出口情况分析3.5

2020-2022年中国芯片国产化进程分析3.5.1 芯片国产化发展背景3.5.2 核心芯片的自给率低3.5.3

芯片国产化进展分析3.5.4 芯片国产化存在问题3.5.5 芯片国产化未来展望3.6

中国芯片产业发展困境分析3.6.1 市场垄断困境3.6.2 贸易依赖非对称性3.6.3 技术短板问题3.6.4

人才短缺问题3.7 中国芯片产业应对策略分析3.7.1 总体发展策略3.7.2 掌握核心技术3.7.3 引进高端人才3.7.4

优化产业链结构3.7.5 增强企业竞争力 第四章 2020-2022年芯片设计行业发展全面分析4.1

2020-2022年全球芯片设计行业发展综述4.1.1 市场发展规模4.1.2 区域市场格局4.1.3 企业排名分析4.2

2020-2022年中国芯片设计行业运行状况4.2.1 行业发展历程4.2.2 市场发展规模4.2.3 专利申请情况4.2.4

资本市场表现4.2.5 细分市场发展4.3 新冠肺炎疫情对中国芯片设计行业的影响分析4.3.1

对芯片设计企业的短期影响4.3.2 对芯片产业链的影响4.3.3 芯片设计企业应对措施4.4

中国芯片设计市场发展格局分析4.4.1 企业竞争格局4.4.2 企业发展状况4.4.3 企业数量规模4.4.4

企业布局动态4.4.5 区域分布格局4.4.6 产品应用分布4.5 芯片设计行业上市公司财务状况分析4.5.1  
上市公司规模4.5.2 上市公司分布4.5.3 经营状况分析4.5.4 盈利能力分析4.5.5 营运能力分析4.5.6  
成长能力分析4.5.7 现金流量分析4.6 芯片设计具体流程剖析4.6.1 规格制定4.6.2 设计细节4.6.3 逻辑设计4.6.4  
电路布局4.6.5 光罩制作4.7 芯片设计行业发展存在的问题和对策4.7.1 人才短缺问题4.7.2 设计能力不足4.7.3  
资本研发投入不足4.7.4 费用支出过多4.7.5 产业发展建议4.7.6 产业创新策略 第五章  
2020-2022年中国芯片设计行业细分产品发展分析5.1 逻辑IC产品设计发展状况5.1.1 CPU 5.1.2 GPU 5.1.3  
MCU 5.1.4 ASIC 5.1.5 FPGA 5.1.6 DSP 5.2 存储IC产品设计发展状况5.2.1 DRAM 5.2.2 NAND  
Flash 5.2.3 NOR Flash 5.3 模拟IC产品设计发展状况5.3.1 射频器件5.3.2 模数/数模转换器5.3.3  
电源管理产品 第六章 中国芯片设计工具——EDA（电子设计自动化）软件市场发展状况6.1  
EDA软件基本概述6.1.1 EDA软件基本概念6.1.2 EDA软件的重要性6.1.3 EDA软件主要类型6.1.4  
EDA软件设计过程6.1.5 EDA软件设计步骤6.2 全球芯片设计EDA软件行业发展分析6.2.1 市场规模状况6.2.2  
细分市场结构6.2.3 区域分布情况6.2.4 主流产品平台6.2.5 竞争梯队分析6.2.6 市场集中度6.3  
中国芯片设计EDA软件行业发展分析6.3.1 产业链结构分析6.3.2 行业发展规模6.3.3 国内竞争格局6.3.4  
行业市场集中度6.3.5 发展前景及趋势6.3.6 行业发展问题6.3.7 行业发展对策6.4  
EDA技术及工具发展沿革及作用6.4.1 GDS&GDS II 6.4.2 SPICE 6.4.3 半导体器件模型（SPICE  
Model）6.4.4 硬件描述语言（HDL）6.4.5 静态时序分析 第七章 中国芯片设计产业园区建设分析7.1  
深圳集成电路设计应用产业园7.1.1 园区发展环境7.1.2 园区基本简介7.1.3 园区战略定位7.1.4  
园区服务内容7.2 北京中关村集成电路设计园7.2.1 园区发展环境7.2.2 园区基本简介7.2.3 园区战略定位7.2.4  
园区建设特色7.2.5 园区发展现状7.2.6 园区发展成果7.2.7 疫情影响分析7.2.8 园区发展规划7.3  
上海集成电路设计产业园7.3.1 园区发展环境7.3.2 园区基本简介7.3.3 园区投资优势7.3.4 园区发展状况7.3.5  
园区项目建设7.4 无锡国家集成电路设计产业园7.4.1 园区发展环境7.4.2 园区基本简介7.4.3  
园区发展状况7.4.4 园区发展成果7.4.5 园区区位优势7.5 杭州集成电路设计产业园7.5.1 园区发展环境7.5.2  
园区基本简介7.5.3 园区签约项目7.5.4 园区发展规划 第八章  
2020-2022年国外芯片设计重点企业经营状况8.1 博通（Broadcom Limited）8.1.1 企业发展概况8.1.2  
企业经营状况8.1.3 芯片业务运营8.1.4 产品研发动态8.2 高通（QUALCOMM, Inc.）8.2.1 企业发展概况8.2.2  
企业经营状况8.2.3 企业业务布局8.2.4 产品研发动态8.2.5 企业发展战略8.3 英伟达（NVIDIA）8.3.1  
企业发展概况8.3.2 企业经营状况8.3.3 企业竞争优势8.3.4 产品研发动态8.4 超微（AMD）8.4.1  
企业发展概况8.4.2 企业经营状况8.4.3 芯片业务状况8.4.4 产品研发动态8.4.5 企业战略合作8.5  
赛灵思（Xilinx）8.5.1 企业发展概况8.5.2 企业经营状况8.5.3 企业业务分布8.5.4 产品研发动态 第九章  
2019-2022年国内芯片设计重点企业经营状况9.1 联发科9.1.1 企业发展概况9.1.2 企业经营状况9.1.3  
企业发展实力9.1.4 重点产品介绍9.2 华为海思9.2.1 企业发展概况9.2.2 企业经营状况9.2.3 业务发展布局9.2.4  
主要产品范围9.3 紫光展锐9.3.1 企业发展概况9.3.2 企业经营状况9.3.3 企业发展实力9.3.4 企业发展布局9.3.5  
企业资本动态9.4 中兴微电子9.4.1 企业发展概况9.4.2 企业经营状况9.4.3 专利研发实力9.4.4  
资本结构变化9.4.5 核心技术进展9.5 华大半导体9.5.1 企业发展概况9.5.2 企业发展实力9.5.3  
重点产品介绍9.5.4 产品研发动态9.5.5 企业合作动态9.6 深圳市汇顶科技股份有限公司9.6.1  
企业发展概况9.6.2 业务发展布局9.6.3 经营效益分析9.6.4 业务经营分析9.6.5 财务状况分析9.6.6  
核心竞争力分析9.6.7 公司发展战略9.6.8 未来前景展望9.7 北京兆易创新科技股份有限公司9.7.1  
企业发展概况9.7.2 业务发展布局9.7.3 经营效益分析9.7.4 业务经营分析9.7.5 财务状况分析9.7.6  
核心竞争力分析9.7.7 公司发展战略9.7.8 未来前景展望 第十章 对芯片设计行业投资价值综合分析10.1  
对集成电路产业投资价值评估及投资建议10.1.1 投资价值综合评估10.1.2 市场机会矩阵分析10.1.3  
产业进入时机分析10.1.4 产业投资风险剖析10.1.5 产业投资策略建议10.2  
对芯片设计行业进入壁垒评估10.2.1 行业竞争壁垒10.2.2 行业技术壁垒10.2.3 行业资金壁垒10.3  
对芯片设计行业投资状况分析10.3.1 产业投资规模10.3.2 产业融资轮次10.3.3 产业投资热点10.3.4  
企业募资规模10.3.5 产业募资动态 第十一章 对2022-2028年芯片设计行业发展趋势和前景预测分析11.1  
中国芯片市场发展机遇分析11.1.1 产业发展机遇分析11.1.2 新兴产业带来机遇11.1.3 产业未来发展趋势11.2  
中国芯片设计行业发展前景展望11.2.1 芯片研发前景11.2.2 市场需求增长11.2.3 行业发展前景11.3  
对2022-2028年中国芯片设计行业预测分析11.3.1 2022-2028年中国芯片设计行业影响因素分析11.3.2  
2022-2028年中国IC设计行业销售规模预测 图表目录 图表1 芯片产品分类 图表2  
集成电路产业链及部分企业 图表3 芯片生产历程 图表4 芯片设计产业图谱 图表5  
2020年GDP终核实数与初步核算数对比 图表6 2021年GDP初步核算数据 图表7  
2022年我国GDP初步核算数据 图表8 2016-2020年全部工业增加值及其增长速度 图表9

2020-2021年规模以上工业增加值同比增长速度 图表10 2021年规模以上工业生产主要数据 图表11  
2021-2022年规模以上工业增加值同比增长速度 图表12 2022年规模以上工业生产主要数据 图表13  
2019-2020年固定资产投资（不含农户）同比增速 图表14  
2020年固定资产投资（不含农户）主要数据 图表15  
2020-2021年全国固定资产投资（不含农户）同比增速 图表16  
2021年固定资产投资（不含农户）主要数据 图表17  
2021-2022年全国固定资产投资（不含农户）同比增速 图表18  
2022年固定资产投资（不含农户）主要数据 图表19  
《中国制造2025》半导体产业政策目标与政策支持 图表20  
2015-2030年IC产业政策目标与发展重点 图表21  
2018-2022年国家层面集成电路行业政策及重点内容解读（一） 图表22  
2018-2022年国家层面集成电路行业政策及重点内容解读（二） 图表23  
2018-2022年国家层面集成电路行业政策及重点内容解读（三）